

翱捷科技(上海)有限公司

2017校园招聘会



- > 公司介绍
- > 产品简介
- 部门介绍
 - . ASIC
 - . ANALOG
 - . SW
 - . CONNECTIVITY
 - · RF

公司介绍



- * 公司名称: 翱捷科技(上海)有限公司(ASR Microelectronic)
- * 成立日期: 2015年4月
- * 产 品:移动智能通讯终端SoC(2G/3G/4G)、物联网、导航及其他消费类电子芯片
- * 公司背景:
 - * 公司创始人为原RDA创始人戴保家先生,并得到业界顶尖基金和上海市政府大力支持,包括 浦东科投,武岳峰资本,华登国际等。
 - * 公司致力于开发移动智能通讯SoC套片,涵盖基带modem,高性能应用处理器,WiFi, BT, GPS, 电源管理等等。与国内主要手机设计公司有紧密的合作。
 - * 公司目前研发人员超过两百人,包括上海,北京,大连,韩国和美国五处研发基地。

企业文化



* 团 队:

ASR的研发团队由业界顶尖通讯芯片设计公司工作多年的资深 专家领衔,同时有中国、美国、韩国的多名资深顾问加盟,技术实力强大。

* 企业文化:

ASR提倡宽松融洽的工作氛围,提供给员工良好的职业成长空间。对于应届毕业生公司将提供非常有针对性的专业指导,快速提升技术水平,顺利实现从学生到专业工程师的转变。

* 薪酬福利:

ASR提供业界非常有竞争力的薪资,以及包括五险一金,补充公积金,商业医疗保险,丰厚的年终 奖和节庆礼品等在内的一系列福利待遇,并且有机会享受公司快速发展带来的股票增值。

* 工作地点:

浦东张江长泰广场,交通和生活都极为便利。

公司产品



- * 智能手机SoC: 旗舰级级别高端应用处理器+2G/3G/4G全模通信modem。
- * Connectivity: WiFi/BT/FM芯片, GPS芯片
- * 电源管理: 高性能PMIC芯片
- * 射频收发器: 2G/3G/4G全模RF transceiver
- * 主要应用对象:高端智能手机,Pad,VR一体机,高端运动相机等等。

市场背景



- * 消费类电子芯片的更新换代快,性价比要求高,随着亚洲工程师技术水平的提高,整个产业处于从欧美向亚洲,尤其是中国的转移过程中。手机SoC厂商从GSM时代的十余家已经压缩到只有三家,除了以专利支撑的高通外,其它欧美厂商全部已退出
- * 手机芯片是整个半导体行业体量最大的逻辑芯片类型,手机研发的主战场在中国。中国的手机品牌和ODM厂商差异化的需要,足够支撑多个芯片平台厂商的发展
- * 手机芯片技术壁垒非常高,除了要求先进工艺外,尤其在中国要支持全网通 (GSM/TD/WCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE/CDMA)是巨大的技术障碍。 ASR是极少数能在所有无线通信模式都有成熟技术厂商,也基本上是全球最 后一个有能力开发全网通手机芯片的厂商。



部门介绍





- * ASIC部门负责公司SoC芯片设计从前到后的全部流程,包括以下工作
 - * Frontend team: modem开发,应用处理器集成,DDR子系统开发,多媒体子系统(包括图形,视频,摄影,显示)开发,外设子系统开发(传感器融合,USB,存储),SoC架构设计,超低功耗技术开发和设计。
 - * Flow team:负责芯片实现流程,包括综合(SYN),时序分析(STA),一致性检查(FV), 低功耗检查(CLP),可测性设计(DFT)。
 - * Backend team:负责芯片后端物理设计,包括布局布线(P&R),芯片集成(INT)以及物理检查(PV)。
- * 目标:采用现在主流的高端工艺(28HPC+, 16FF, etc),以及EDA的先进工具,设计性价比最好的高端手机SoC。

ASIC JD



- * ASIC部门招聘以下类别数字设计人员:
 - * Frontend team: 熟悉RTL设计和验证流程, 熟悉基本的AMBA总线架构, 对以下之一有了解尤佳:
 - * CPU, GPU, video codec, ISP, eMMC, UFS, USB
 - * 复杂算法的RTL实现
 - * Flow team: 了解数字电路的综合和时序概念,或者对DFT有了解
 - * Backend team: 了解数字电路的物理实现,对半导体工艺和流程有清晰概念
- * 毕业生有机会接触芯片设计的全流程,并且可以根据个人兴趣在不同部门中 轮换,成长为技术全面,业务专精的高级人才。





- * Analog部门的职能为:为公司的产品开发高性能analog IP,并和ASIC、RF部门一起完成产品化的流程
- * 产品包括但不限于:
 - * 高速serdes接口:包括MIPI M-PHY/D-PHY, LPDDR4, USB3.0, EMMC etc.
 - * 用于RF transceiver的高速高精度ADC、DAC, filter, XTAL-OSC等
 - * 大电流高性能PMIC: >5A DC-DC / Charger
 - * HIFI 级别audio codec(SNR>110dB DAC, class-D)
 - * 其他高性能Analog IP: low-noise Bandgap, high-PSRR LDO, temp sensor etc...



Analog JD

* 掌握基本模拟电路分析的方法

- * 熟悉小信号电路分析的方法
- * 了解噪声,反馈,稳定性,器件匹配,非线性,phase noise、jitter等基本理论和分析方法;
- * 会运用信号与系统的方法来分析电路特性
- * 在下面领域有一定的设计经验,如有流片结果更佳:
 - * 低噪声高精度电路; 高速ADC、DAC; PLL/synthesizer; 高速serdes接口; clock-and-data recovery (CDR); PMIC (DC-DC); audio codec 等
- * 热爱模拟电路设计

Analog团队



* 团队文化

- * 小而精,快速、高效的团队
- * 管理架构扁平,工程师文化
- * 技术是产品的灵魂

* 加入我们的你会得到:

- * 大牛的指导:
- * 接触最新一代高性能模拟产品
- * 更广阔的发展前景
- * 成为技术精英
- * 从电路到系统→产品架构师,项目经理

SW (软件)



- * SW部门负责公司芯片整体软件解决方案的设计实现
 - * 芯片的需求分析和系统验证
 - * 你可以接触到芯片和硬件的各种知识,参与软硬件系统的结合设计等
 - * 基于Android的智能手机和平板整体解决方案,实现高性能的通讯,多媒体,摄像等自有方案
 - * 你可以参与Linux驱动开发,Android系统软件开发,通讯系统开发,音视频系统开发,图形和图像算法设计实现等
 - * 高性能的VR一体机平台方案
 - * 你可以参与最前沿的VR系统设计,包括高精的传感器方案,超高清的显示和图形系统加速等
 - * 高质量ISP(Image Signal Processor)解决方案
 - * ISP 算法以及系统设计; 高质量2D/3D降噪算法开发; 高速对焦方案开发; Dual Camera系统算法开发;

SW JD



- * 嵌入式软件开发工程师
 - * 芯片的firmware开发, Linux OS/Driver开发, Android模块开发
 - * 了解嵌入式开发,熟悉计算机体系架构和操作系统
- * 多媒体算法软件开发工程师
 - * Audio/Voice/Sensor算法设计和优化实现
 - * 掌握数字信号处理,了解音频编码或传感器算法,会使用matlab
- * 多媒体系统软件开发工程师
 - * Audio/Video的驱动和中间件的开发和优化, Android框架软件开发
 - * 掌握基本的编解码知识,了解多媒体播放器,音频接口等
- * 图形和显示系统开发工程师
 - * 开发Display/GPU驱动, Android/VR显示系统优化
 - * 有较好的图形和数学基础

SW JD



- * ISP(Image Signal Processor)算法研发工程师
 - * 负责研究并实现ISP相关算法,协同芯片设计人员,开发高质量ISP系统,提升图像质量;
 - * 查阅论文及专利, 跟踪和研究领域内最新技术, 推动算法演进;
 - * 优化改进算法,平衡算法复杂度,功耗消耗,内存使用以及芯片面积;
 - * 利用DSP/Neon优化ISP前后处理算法,提升相机系统客户体验度;

* 岗位要求:

- * 硕士学位及以上, 计算机、电子工程、图像处理、色彩科学、光电技术、光学工程等相关专业;
- * 扎实的数字图像理论基础,熟练掌握各种图像处理算法,例如各种滤波器、降噪、锐化、特征提取等;
- * 具备良好的编程能力,熟练掌握C/C 或者Matlab;

Connectivity (通信)



* Connectivity部门的工作职能

为公司的通信传输/信号处理类产品开发高性能的数字算法,并和RF部门及软硬件部门一起完成整个S00产品的研发

* Connectivity部门的工作内容

- * 数字通信算法的设计与评估
- * 数字信号处理/自适应信号处理算法的设计与评估
- * 与模拟电路相关联的数字预补偿和后处理
- * 与系统工作相关联的芯片矫正工作与流程控制
- * 与软硬件实现工程师交流沟通优化算法开销





* 通信算法工程师

- * 熟悉通信系统的各部分构成,尤其是MIMO和OFDM系统
- * 能够用MATLAB/C仿真算法的性能,并对该算法进行改进以及优化
- * 能够综合考虑各部分因素, 从几种备选算法中评估出最佳的方案
- * 能够将浮点算法定点化并完成算法文档的撰写

* 算法实现工程师

- * 能够估算简单算法的复杂度以及所需要的资源需求
- * 能够快速理解算法所需操作并完成软件或者硬件代码的编写
- * 能够根据所理解的算法文档完成软件或者硬件实现文档
- * 能够准确算出完成算法操作所需要的时间



Connectivity JD

- * 硕士学位及以上,学习过通信原理/数字通信/信号与系统/数字信号处理等
- * 对以下算法细节有经验者优先
 - * 信道编解码如BCH码, R-S码, 卷积码, Turbo码, LDPC码
 - * 单载波/多载波通信系统中的信道估计和信道均衡
 - * 常用的载波环路以及采样环路的捕获以及跟踪过程
 - * 多天线技术中的分集合并和波束成形的基本操作
 - * 数字滤波器以及数字变频处理
- * 有以下开发经验者优先
 - * 熟悉WIFI/BT等标准的通信协议规范或者协议栈规范
 - * 完成某个算法在FPGA/DSP等器件上实现
 - * 成功开发过软件或者硬件系统
- * 能够估算简单算法的复杂度以及所需要的资源需求
- * 能够快速理解算法所需操作并完成软件或者硬件代码的编写
- * 能够根据所理解的算法撰写算法文档和软件/硬件实现文档
- * 具备较好的英语读写能力,能快速查阅相关论文、专利等

RF(射频)



* RF 部门职能:

* 采用先进工艺设计高性能、高复杂度、高集成度射频芯片,包括射频单芯片以及集成 SoC芯片

* 产品包括但不限于:

- * 多模多频带手机射频收发芯片(2G/3G/4G),支持全网通以及先进的LTE 载波聚合功能,覆盖 700MHz~2700MHz 频段
- * 5G RF/Microwave收发器射频芯片 (5GHz, 28GHz, etc)
- * 连接性产品: 包括 WiFi/BT/FM/GNSS全模导航等射频芯片
- * 物联网相关产品: IoT 相关收发器射频芯片
- * 射频前端模块(FEM)产品:高性能PA,LNA,Switch,IPD等
- * 高性能RF电路研究:进行前沿的高性能RF电路研究。比如:超宽调谐 VCO、低噪声高线性度射频前端、高线性度发射前端等

RFJD



* 射频集成电路设计工程师

- * 掌握射频电路基本概念及分析方法
 - * 理解噪声系数、噪声级联计算、噪声传递函数推导、输入匹配等
 - * 理解电路的线性度指标 IP2/IP3、P1dB并且对于电路非线性来源有清晰的认识
 - * 理解 PLL 基本原理, 各级的传递函数推导等
 - * 具有扎实模拟电路基础如 OPA, BGR, LDO 等
 - * 对射频电路版图设计有一定的了解和实践
- * 成功设计并且测试过下列一种或多种电路
 - * LNA、Mixer、VCO、PLL、PA、PA driver
 - * Passive device modeling: inductor, transformer et al
 - * OPA、Filter、BGR、ADC/DAC、LDO et al.
- * 对于设计顶尖射频电路有执着的追求并且有行动力
- * 具有钻研精神以及强烈的团队合作意识

RF 团队建设



- * 我们努力并且有信心
 - * 成为顶尖的射频 IC 设计团队,致力于设计世界一流的射频芯片
- * 加入我们你有机会
 - * 接触到最先进的射频电路设计方法
 - * 设计高性能、高复杂度、极具挑战的射频电路
 - * 在非常融洽的氛围内工作、学习、成长
 - * 成为射频电路设计领域的佼佼者



感谢各位同学出席!

我们的联系邮箱: HR@asrmicro.com